

EV Group announces NanoCleave layer release new technology... participated in Semicon Korea Show 2024– January 30, 2024

EVG introduced NanoCleave™, a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave enables silicon wafer carriers in advanced packaging processes such as FoWLP using mold and reconstituted wafers as well as interposers for 3D SIC. At the same time, its compatibility with high-temperature processes enables completely novel process flows for 3D IC and 3D sequential integration applications – enabling hybrid and fusion bonding even of ultra-thin layers on silicon carriers, thereby revolutionizing 3D and heterogeneous integration as well as material transfer in next-generation scaled transistor designs. EVG will participate in the Semicon Korea 2024 exhibition held at COEX from the 31st to February 2nd and introduce new NanoCleave technology.

반도체

EV그룹 나노클레이브 레이어 릴리즈 신기술 발표...세미콘 2024 참가

나시인데일리 | 발행일 2024-01-30 16:12:22

김문기 기자 |



EVG, Photo EVG850 NanoCleave external view [사진=EVG]

[디지털데일리 김문기 기자] EV그룹(EVG, 지사장 운영식)은 반도체 제조를 위한 레이어 릴리즈 기술인 나노클레이브(NanoCleave)를 출시한다고 30일 발표했다.

이 기술은 첨단 로직, 메모리, 전력 반도체 프론트엔드 공정은 물론 첨단 반도체 패키징에 초박형 레이어 적층을 가능하게 한다. 나노클레이브는 반도체 선 공정에 완벽하게 호환되는 레이어 릴리즈 기술로서, 실리콘을 투과하는 적외선 레이저를 사용하는 것이 특징이다. 또한 특수 조성된 무기 박막과 함께 사용할 경우, 나노미터의 정밀도로 초박형 필름이나 레이어를 실리콘 캐리어로부터 적외선 레이저로 분리할 수 있게 해준다.

나노클레이브는 EMC(epoxy mold compounds)와 재구성 웨이퍼(reconstituted wafer)를 사용하는 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FoWLP)에서부터 3D SIC(3D Stacking IC)의 인터포저 같은 첨단 패키징 공정에서 실리콘 웨이퍼 캐리어 사용 가능하게 한다.

뿐만 아니라, 고온 공정에도 적용할 수 있어 3D IC 및 3D 순차 집적 애플리케이션에서 완전히 새로운 공정 플로우를 구현할 수가 있다. 이는 실리콘 캐리어 상의 초박형 레이어까지도 하이브리드 및 퓨전 본딩이 가능해, 3D 및 이중 집적에 혁신을 가져다줄 뿐만 아니라 차세대 트랜지스터 집적화 설계에서 필요한 레이어 이송을 가능하게 한다.

EVG는 코엑스에서 오는 31일부터 2월 2일까지 개최되는 세미콘 코리아 2024 전시회에 참가해 나노클레이브 신기술을 소개한다. EVG 부스를 방문하면 EVG 임원들을 직접 만나서 이 혁신적인 이 적외선 레이저 이송 기술에 관해서 논의할 수 있다.

2024



많이 본 :

- 1 [행정 부, IT
- 2 구할 생존
- 3 삼삼 스피
- 4 '예측 LG엔
- 5 [행정 관제

연세:

bill

